



2025 年 9 月 17 日

各 位

会 社 名 ティアンドエスグループ株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 武川 義浩
 (コード番号：4055 東証グロース)
問合せ先 取締役執行役員 COO 木下 洋
 (TEL.045-263-8286)

「T&S Growth Journey 2031」の公表について

当社は、2031 年に向けた長期ビジョン「T&S Growth Journey 2031」を策定し、財務目標数値を設定いたしましたので、お知らせいたします。また、その施策遂行のために、横浜キャピタルとの事業提携、及び第三者割当による新株予約権の発行を決議しておりますので、その関連性についてお知らせいたします。

1. 長期ビジョン

当社グループは、あらゆる産業において、ソフトウェア技術が生み出す新たな付加価値を通じて、お客様に安心と満足そして豊かさを提供すると共に、社員を大切に、株主様に貢献するという企業理念のもと、顧客企業に安心と信頼を預けるソフトウェア開発と保守運用を基盤に、最先端の AI 事業を拡大し、事業の継続的成長を図り、企業の社会的責任を果たすべく邁進してまいりました。とりわけ、半導体や重電といった領域でのソリューション提供を強みに、AI 技術を駆使した研究開発支援など、特徴のあるシステムインテグレーターとして、ここまで成長を遂げてまいりました。

そのような中、当社グループは、2024 年 12 月 17 日公表の「事業計画及び成長可能性に関する事項」におきまして、2035 年までに、売上高 100 億円、時価総額 300 億円の長期目標を掲げておりますが、今般、その具体的な施策を見直した結果、達成目標の前倒しとなる改訂を行いました。改定後の財務目標数値は以下のとおりです。

	売上高	EBITDA	時価総額
2031年	100億円	20億円	300億円

2. 横浜キャピタルとの事業提携及び第三者割当による新株予約権の発行

本日公表の「事業提携に関するお知らせ」及び、「第三者割当により発行される第 6 回新株予約権の募集に関するお知らせ」のとおり、当社は横浜キャピタル株式会社と事業提携契約を締結し、上述の長期ビジョンにおいて、当社グループが目指すミッション実現のための諸施策に対し有益な助言を得ることを予定しており、また、同社が設立した Yokohama Bridge 投資事業有限責任組合に対する新株予約権の発行による資金調達を行うことといたしました。なお、当該新株予約権は、既存株主の皆様への希薄化影響を抑制するため、割当予定先との間で行使価額及び行使可能期間に関する行使制限を付しております。

3. 事業計画及び成長可能性に関する事項

上述の長期ビジョンの決定を受け、具体的な事業計画を策定してまいります。詳細につきましては、当期（2025 年 9 月期）の通期決算発表後の適切な時期に、「事業計画及び成長可能性に関する事項」として、公表を予定しております。

以 上

長期ビジョン T&S Growth Journey 2031 — 成長の軌跡とその先へ

ティアンドエスグループ株式会社

(東証グロース 4055)

2025.9.17



T&S
Technology & Service

長期目標の達成前倒し宣言

T&S Growth Journey 2031

2031年に向けて、T&Sグループは下記の3つの姿を追求していきます。

(1) 半導体領域におけるナンバーワン・システムインテグレーター

(2) AI事業の独自ブランド化を起点とする高速成長

(3) そしてこれらを支えるエンジニア規模の拡大

その結果、2031年のT&Sグループの財務指標目標は次のとおりです。

	売上高	EBITDA	時価総額
2031年	100億円	20億円	300億円

※ 当社グループは、2035年までに、売上高100億円、時価総額300億円の長期目標を掲げておりますが、今般、その具体的な施策を見直した結果、達成目標の前倒しとなる改訂を行いました。

主要な見直しポイント（数値の内訳はP5参照）

	従来目標	前倒し目標
エンジニア数	毎年10%のエンジニア増員とそれによる売上増（変更なし）	
単価アップ	平均物価上昇率程度の単価up	昨今の物価上昇率、セールスマックスの改善、及びAI浸透による非労働集約的ビジネスの拡大を考慮した、より高い単価上昇の獲得
ビジネスモデル	現在の延長線上での拡大	半導体×AIを前面に打ち出すビジネスの推進
M&A	水平的統合による規模拡大	半導体×AI領域の深耕と、それを支えるリソースの拡充を目的

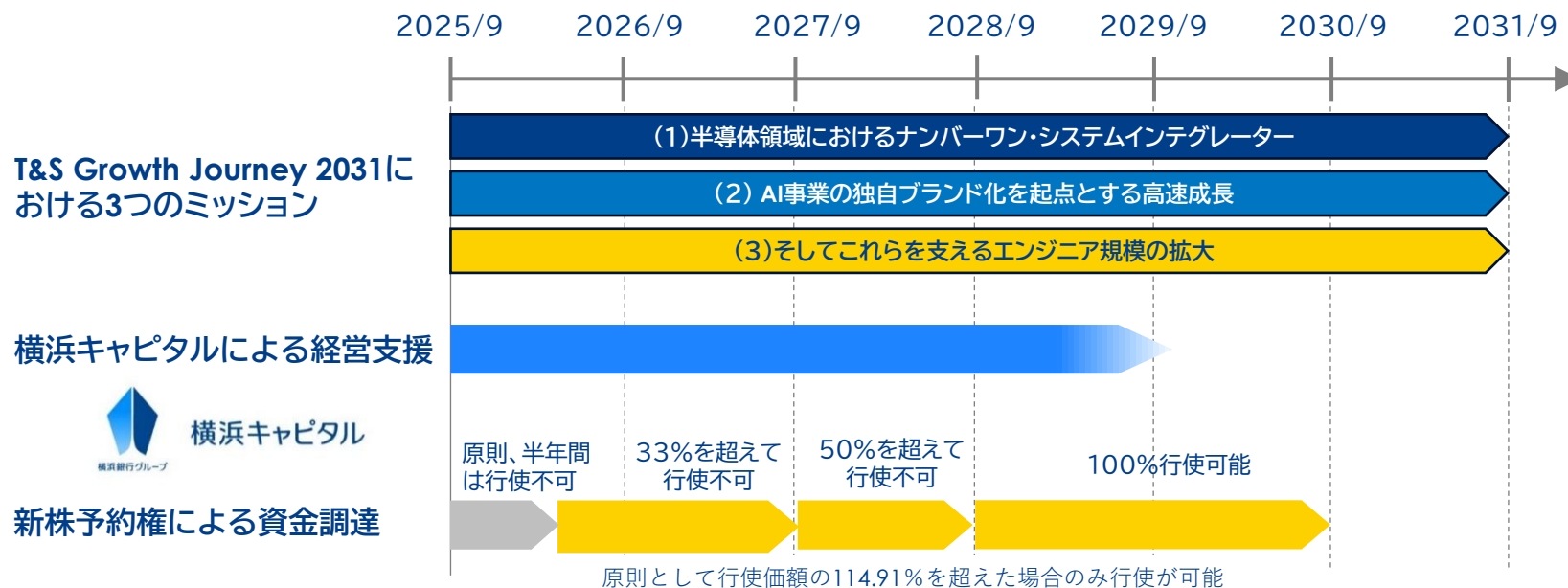
長期ビジョン「T&S Growth Journey 2031 ― 成長の軌跡とその先へ」

ミッション	実行すべき施策
(1)半導体領域におけるナンバーワン・システムインテグレーター	・既存顧客との取引のさらなる深耕 ・半導体サプライチェーンに属する新規顧客の開拓 ・半導体SIサプライチェーンの延伸(例:システム導入コンサル、ソフトウェア検証業務) ・半導体SIの要素拡大(例:生成AIの活用、生産管理以外の分野(生産工程、製品企画等)) ・半導体SIの領域拡大(例:装置メーカー、素材メーカー) ・上記に関する同業他社とのM&A ・他業種との連携(例:半導体製品商社、材料商社、製造装置商社、コンサル会社)
(2) AI事業の独自ブランド化を起点とする高速成長	・当社コア技術のIP化によるビジネスモデルの変革(半導体×AI、製造業×AI) ・R&Dからの新事業創出及び半導体/DXカテゴリーへの展開 ・M&Aによる事業領域の拡大
(3)そしてこれらを支えるエンジニア規模の拡大	・採用活動の強化 ・従業員待遇の向上 ・採用チャネルの拡大 ・採用、人材育成体制の増強 ・規模拡大に対応したDX化推進 ・知名度向上作戦 ・同業他社とのM&A

ミッションマスター（投資ポイント）

- ①採用・人材基盤強化
- ②M&A又は事業・資本提携による事業の拡大
- ③DX推進による営業基盤の拡充と生産性の向上

横浜キャピタルとの事業提携及び新株予約権による資金調達



	新株予約権
調達金額	13.5億円
割当日	2025年10月3日
行使可能期間	半年後から5年後
行使価額	1,196円
行使可能価額	1,374円

本新株予約権の特徴

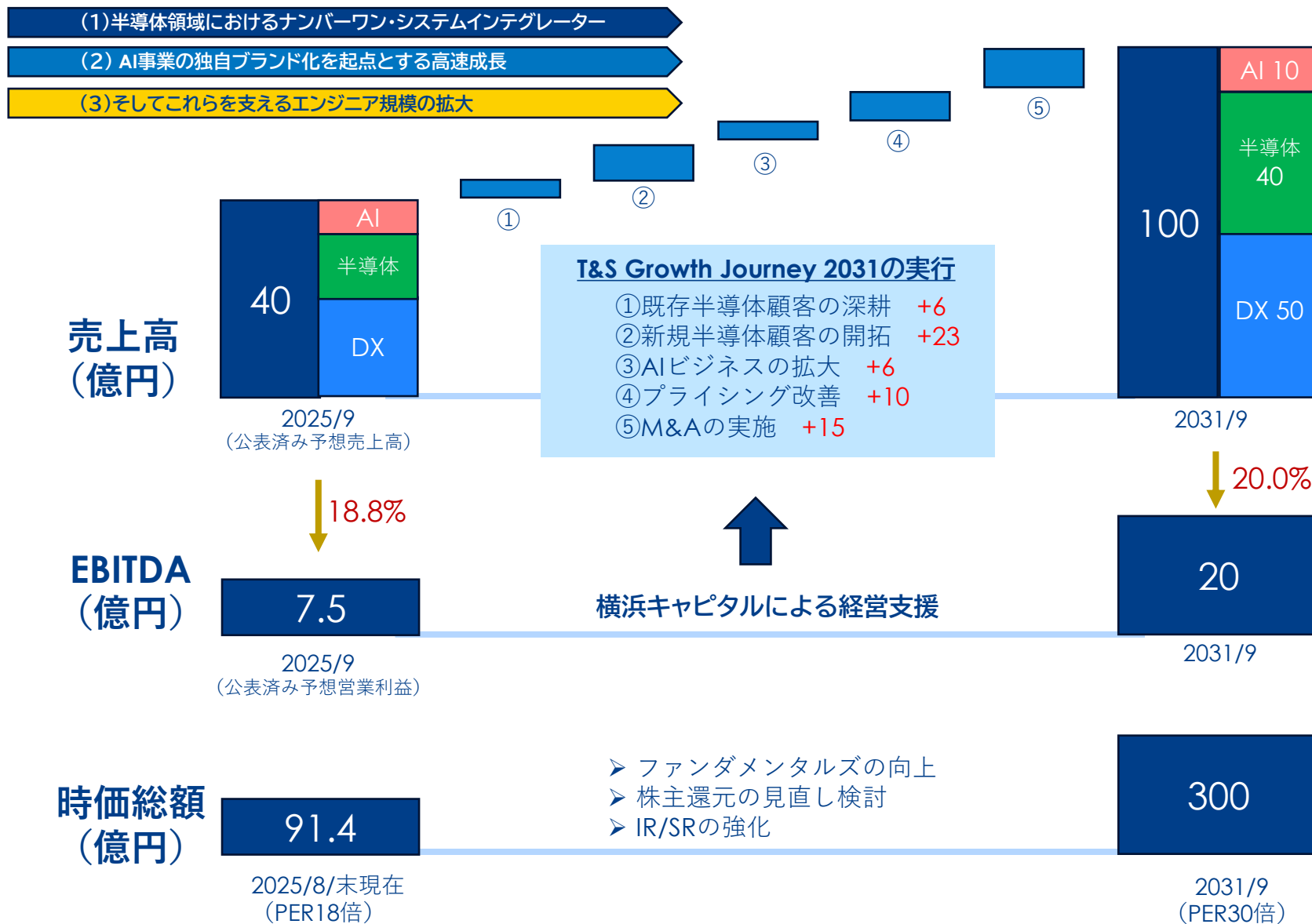
- 原則として株価が行使価額の114.91%を超えた場合のみ行使が可能
- 普通株式への転換可能期間を半年後以降、段階的に設定し即座の希薄化を防止

施策遂行のためのミッションマスター(投資ポイント)

①採用・人材基盤強化	525百万円
②M&A又は事業・資本提携による事業の拡大	595百万円
③DX推進による営業基盤の拡充と生産性の向上	230百万円



2031年9月期 売上高100億円、EBITDA20億円



お問い合わせ先

ティアンドエスグループ株式会社

経営企画IR部

Email / pr@tecsvc.co.jp

URL / <https://www.tecsvc.co.jp/>

本資料に掲載されている情報には、将来の見通しに関するものが含まれています。これらの情報については、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その実現や将来の業績を保証するものではありません。経済状況の変化や一般的な業界ならびに顧客ニーズの変化、法規制の変更等、様々な要因によって当該予想と大きく異なる可能性があります。今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合において、本資料に含まれる将来に関するいかなる情報についても、更新又は改訂を行う義務を負うものではありません。